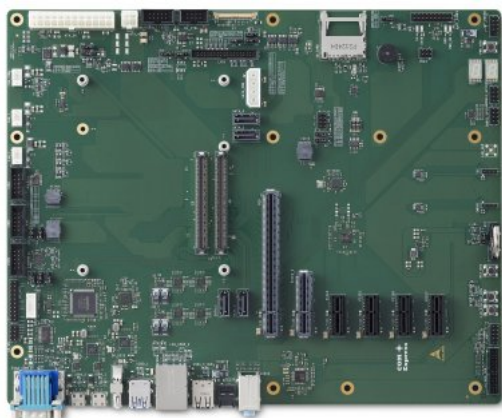


PICMG® が最新の COM.0 R3.1 仕様をリリース COM Express に PCIe Gen 4 および USB 4.0 のサポートを追加

COM Express R3.1 準拠のモジュール - ADLINK、Express-ADP Type6 ベーシックサイズ、Express-ID7 Type7 ベーシックサイズをリリース



- ・ COM.0 R3.1 は、すべてのモジュールタイプで PCIe Gen 4 をサポートし、Type 6 では USB4 をサポート、10G イーサネットでは CEI サイドバンド信号をサポートし、Type 7 では 2 つ目の PCIe Clock を追加しています。

- ・ R3.1 に準拠し、ADLINK は 2 つの新しいモジュールと、すぐに使用できる開発キットを提供します。

- [Express-ADP Type 6 ベーシックサイズ](#) : 第12世代インテル® Core™ 搭載、TDP 15W/28W/45W、最大6つのパフォーマンスコア (Pコア) と8つのエフィシエントコア (Eコア) の先進のハイブリッドアーキテクチャをサポート

- [Express-ID7 Type7 ベーシックサイズ](#) : インテル® Xeon® D-1700 搭載、最大4つの10G の高速イーサネットと16のPCIe Gen4 レーンによる瞬時の応答性とパフォーマンス

2022年10月6日 - エッジコンピューティングのグローバルリーダーであり、PICMG® 小委員会の議長を務める [ADLINK Technology](#) は、PICMG の最新の COM.0 R3.1 と、リビジョンに準拠した2つの新しい COM Express モジュール (Express ADP Type 6 ベーシックサイズ および Express-ID7 Type 7 ベーシックサイズ) をリリースできることを嬉しく思います。

R3.0 と比較して、Revision 3.1 では、すべてのモジュールタイプで PCIe Gen4 をサポートし、Type 6 では USB4、2 番目の PCIe Clock を追加し、Type 7 では 10G Ethernet をアップデートして CEI サイドバンド信号をサポートするなど、次世代 AIoT アプリケーションに適した複数の先進インタフェースのサポートを追加しています。その他の機能強化としては、汎用 SPI、MIPI-CSI コネクタ、SoundWire のオプション追加、Type 7 の IPMB の追加などがあります。

R3.1 準拠の ADLINK の Express-ADP Type 6 ベーシックサイズ と Express-ID7 Type 7 ベーシックサイズのモジュールは、それぞれ第12世代インテル® Core™ とインテル® Xeon® D-1700 プロセッサを搭載しています。

ADLINK の Express-ADP Type 6 ベーシックサイズは、最大6つの Performance Core (Pコア) と8つの Efficient Core (Eコア) を備えた先進のハイブリッドアーキテクチャに基づく第12世代インテル® Core™ プロセッサを利用し、幅広い展開において生産性を効果的に向上させ IoT イノベーションに拍車をかけます。最大 4800MT/s の DDR5 メモリサポートと増加したキャッシュを組み合わせ、最大 96 EU の統合インテル® Iris® Xe グラフィックスを提供し、4 つの同時 4K60 HDR ディスプレイと優れた AI 性能を実現するインテル® ディープラーニング・ブーストを提供します。DDI、eDP 1.4b、USB4/TBT4 を使用し、4 つの独立したディスプレイはディスプレイ代替モードをサポートし、このモジュールは優れたコンテンツサポート、ディスプレイおよび I/O 仮想化のためのプレミアムグラフィックス機能を提供します。

インテル® Xeon® D-1700 プロセッサをベースにした ADLINK の Express-ID7 Type 7 ベーシックサイズは、最大4つの10Gの統合高速イーサネットと16のPCIe Gen4レーンを組み合わせ、瞬時の応答性とパフォーマンスを実現しています。堅牢でエッジAIアプリケーション向けに構築されたこのインテル® Ice Lake-D 搭載 ADLINK

